深圳清溢光电股份有限公司

公司代码:688138　　公司简称:清溢光电

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在年度报告中详细描述了存在的风险因素,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-四、风险因素"中关于风险因素的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为持续稳定地回报股东,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本266,800,000股,扣减回购专用证券账户中股份数1,723,419股后为265,076,581股,以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币42,412,252.96元(含税),占公司2023年度归属于母公司所有者的净利润的31.68%。公司2023年度不进行资本公积转增股本、不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配预案已经第九届董事会第十七次会议审议决议,高需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	清溢光电	688138	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	秦芩	刘元
办公地址	深圳市南山区阳山二路北清溢光电大楼	深圳市南山区阳山二路北清溢光电大楼
电话	0755-86359868	0755-86359868
电子信箱	qyg@supermask.com	qyg@supermask.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司的主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形"底片"转移用的高精密工具,是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。掩膜版用于下游电子元器件制造业批量生产,是下游行业生产流程的关键模具,是下游产品精度和质量的决定因素之一。报告期内,公司主要业务及产品未发生重大变化。

公司生产的掩膜版产品根据基板材质的不同主要可分为石英掩膜版、苏打掩膜版和其他(包含凸版、菲林)。产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业,是下游行业产品制程的关键工具。公司掩膜版产品主要应用的下游行业和相关客户情况如下:

平板显示行业掩膜版包括薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)掩膜版含阵列(Array)掩膜版(a-Si/LTPS技术)及彩色滤光片(CF)掩膜版、有源矩阵有机发光二极管显示器(AMOLED)掩膜版、超扭曲向列型液晶显示器(STN-LCD)掩膜版和Fine Metal Mask掩膜版、MicroLED显示掩膜版和Micro OLED显示掩膜版等。服务的典型客户包括京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电、信利、龙腾光电、群创光电、瀚宇彩晶等客户。

半导体芯片行业掩膜版主要包括半导体集成电路凸块(IC Bumping)掩膜版、集成电路代工(IC Foundry)掩膜版、集成电路载板(IC Substrate)掩膜版、发光二极管(LED)封装掩膜版及微机电(MEMS)掩膜版等。服务的典型客户包括芯联集成、三安光电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、华微电子、赛微电子和长电科技等客户。

触控行业掩膜版主要包括内嵌式触控面板(In Cell、On Cell)掩膜版、外挂式触控(OGS、Metal Mesh)掩膜版、触控屏用纳米压印掩膜版。服务的典型客户包括京东方、天马等。

电路板行业掩膜版主要包括柔性电路板(FPC)掩膜版、高密度互连线路板(HDI)掩膜版。服务的典型客户包括紫翔电子、鹏鼎控股等。

(二) 主要经营模式

公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式及市场开拓模式如下:

1、盈利模式。从上游供应商采购原材料,针对客户个性化的需求,通过公司专业化设计,在自有的恒温、恒湿高洁净度生产车间使用高精密设备,通过多个高度专业化的生产流程,将原材料制作成符合客户定制化需求的产品,并交付给客户,实现产品销售并获得盈利。

2、研发模式。公司自成立以来,为打破国外垄断、填补国内空白,始终坚持自主研发、自主创新的研发模式。作为国内规模最大的掩膜版专业制造商之一,公司始终致力于探索、改进掩膜版的工艺制造流程,提升产品良率,提高生产制造效率,同时对于掩膜版生产所需的部分设备进行了研发、改进,从工艺到设备多角度提升掩膜版产品性能。

3、采购模式。公司设立采购部,主管供应商的开发与管理、原材料采购工作。公司根据相关产品的行业特点,制定和执行供应链管理环境下的采购模式,通过实施有效的计划、组织与控制等采购管理活动,按需求计划实施采购。

采购分为境内采购和境外采购。境内采购,因物资采购周期比较短,需求比较稳定,采购人员根据月、周采购计划,结合物资的采购周期、检验周期,在与各合格供应商签订采购框架协议的前提下,每月/周以采购订单的形式,实施采购。境外采购,因物资采购周期相对较长、流程繁杂,采购部门指定专业人员负责采购,由负责采购的人员根据月/周采购计划,结合物资的采购周期、检验周期,每笔以采购合同的形式实施采购。计划外采购的物资,由相关部门以物资需求申请单的形式提出,经批准后,交采购部门实施采购。

4、生产模式。公司产品全部由公司自行生产,不存在外协生产的情况。掩膜版为定制化产品,公司采用"以销定产"的生产模式,根据客户订单需求情况进行生产调度、管理和控制。通常客户单次采购的量较少,对所采购产品的品质要求较高,同时对交货期要求严格,因此公司的产品制造过程中的品质管理能力和按时交货能力至关重要。

公司针对不同的客户需求自主创新开发,或根据职能出的产品成立专门的项目组,由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求,设计开发工艺技术方案,并制作产品,送交客户认证。

5、销售模式。公司的销售模式均为直接销售,即公司直接与客户签署合同,直接将货物交付至客户指定的地点,客户直接与公司进行结算。

6、市场开拓模式。公司采取两种市场开拓模式:自行开拓模式、代理商开拓模式。

①自行开拓模式:公司自行通过行业交流、展会宣传以及老客户口碑相传等形式开拓新的客户资源。

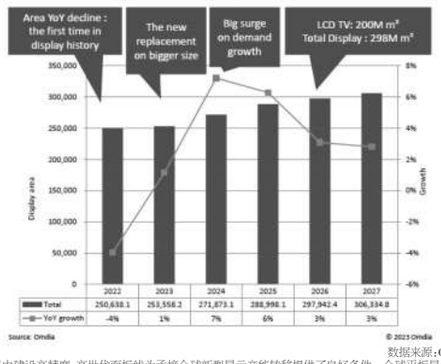
②代理商开拓模式:代理商自行接洽境外潜在需求客户,如开拓成功,客户将订单直接下达给公司,款项与货物通过客户直接与公司往来,代理商不参与交易过程中的具体环节。公司按客户成交金额根据事先与代理商约定的佣金比例计算具体佣金金额。通常在收到客户的付款之后,公司再向代理商支付佣金。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1)平板显示市场

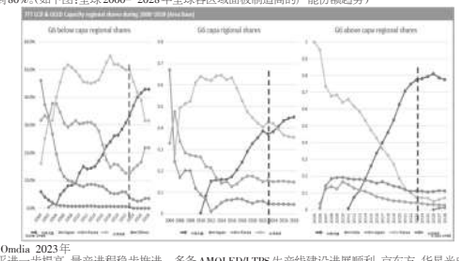
平板显示行业长期发展呈现像素高精度化、尺寸大型化、竞争白热化、转移加速化、产品定制化等特点,受益于电视平均尺寸增加、大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动,根据Omdia 2023年9月预测,2027年全球平板显示需求超过300百万平方米。(如下图:全球2022-2027年平板显示需求预测,单位:百万平米)



数据来源:Omdia 2023年

近年来我国集中建设高精度、高世代面板线为承接全球新型显示产能转移提供了良好条件,全球平板显示产业布局向中国转移的进程明显加快。我国平板显示产业集中度进一步提高,京津 唐、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区都拥有高精度、高世代面板线。我国平板显示 产业呈现以下特征:

①产业规模持续扩大,自给能力稳步提升,市场占有率持续增长,中国大陆已经成为全球面 板产能最多的地区。根据Omdia 2023年9月预计,全球各区域面板制造商的产能份额中,在2026年中国大陆6代产能占比将达到45%左右,6代以上产能占比将达到80%。(如下图:全球2000- 2028年全球各区域面板制造商的产能份额趋势)



数据来源:Omdia 2023年

②技术水平进一步提高,量产进程稳步推进。多条AMOLED/LTPS生产线建设进展顺利,京东方、华星光电、天马、维信诺、和辉光电等企业在AMOLED/LTPS高分辨率、折叠屏、全面屏、高饱和度等新技术上加大投入。

③本土产业链不断完善,配套体系逐步形成,平板显示产业上游设备和材料领域国产化率进一步提升。根据Omdia 2023年9月统计分析,预计2024年有24条8.5代以上高世代线,其中8.5/8.6代合计有19条,中国大陆AMOLED/LTPS制造商仍在继续扩大投资,到2024年,中国大陆预计有23条中精度及高精度AMOLED/LTPS/a-Si。

预计2024年有19条8.5/8.6代高精度TFT产线,产线情况如下:

序号	生产商	工厂	应用	主要技术	代数
1	京东方	BOE B4	LCD	a-Si	8.5
2	京东方	BOE B5	LCD+OLED	a-Si	8.5
3	京东方	BOE B8	LCD	a-Si	8.5
4	京东方	BOE B10	LCD	a-Si	8.5
5	京东方	BOE B18	LCD	Oxide	8.5
6	京东方	BOE B19	LCD	Oxide	8.6
7	华星光电	CSOT T1	LCD+EPD	a-Si	8.5
8	华星光电	CSOT T2	LCD	a-Si	8.5
9	华星光电	CSOT T9	LCD	a-Si/Oxide	8.6
10	华星光电	CSOT T10	LCD	a-Si	8.5
11	惠科	HKC H1	LCD	a-Si	8.6
12	惠科	HKC H2	LCD	a-Si	8.6
13	惠科	HKC H4	LCD	a-Si	8.6
14	惠科	HKC H5	LCD	a-Si	8.6
15	咸阳彩虹	CECX 1	LCD	a-Si	8.6
16	LG Display	LGD GP1	LCD	a-Si	8.5
17	LG Display	LGD GP3	OLED	Oxide	8.5
18	天马	Tianma TM19	LCD	a-Si/Oxide	8.6
19	泰嘉	Taijia	LCD	a-Si	8.5

数据来源:Omdia 2023年

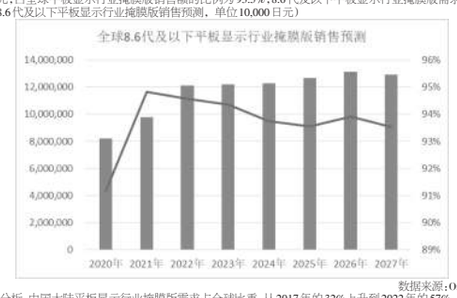
预计2024年有23条中精度及高精度AMOLED/LTPS/a-Si情况如下:

序号	生产商	工厂	应用	主要技术	代数	备注
1	友达光电	AUO L6K	LCD	LTPS	6	
2	京东方	BOE B3	LCD	a-Si	6	
3	京东方	BOE B6	LCD+OLED	LTPS	5.5	
4	京东方	BOE B7	OLED	LTPS	6	
5	京东方	BOE B11	OLED	LTPS	6	
6	京东方	BOE B12	OLED	LTPS	6	
7	京东方	BOE B20	LCD+Micro LED	LTPS	6	
8	京东方	BOE B16	OLED	-	8.6	Planning
9	中电熊猫	C1	LCD	a-Si	6	
10	华星光电	CSOT T4	OLED	LTPS	6	
11	华星光电	CSOT T3	LCD	LTPS	6	
12	华星光电	CSOT T5	OLED	LTPS	6	
13	和辉光电	Everdisplay 1	OLED	LTPS	4.5	
14	和辉光电	Everdisplay 2	OLED	LTPS	6	
15	华佳彩	MDT 1	LCD+OLED	a-Si	6	
16	天马	TM15	OLED	LTPS	5.5	
17	天马	TM16	LCD+OLED	LTPS	6	
18	天马	TM17	OLED	LTPS	6	
19	天马	TM18	OLED	LTPS	6	
20	维信诺	VSX V1	OLED	LTPS	5.5	
21	维信诺	VSX V2	OLED	LTPS	6	
22	维信诺	VSX V3	OLED	LTPS	6	
23	维信诺	VSX V4	OLED	LTPS	8.6	Planning

数据来源:Omdia 2023年

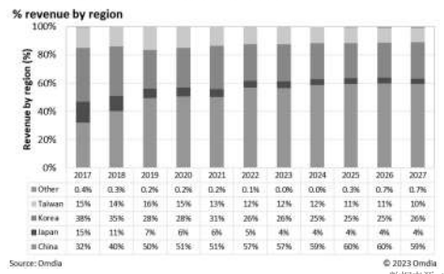
平板显示领域的同一世代生产线,根据下游显示产品的需求,对分辨率、尺寸等主要技术指标的要求不同,进而对掩膜版精度的要求也存在高、中、低差异。

未来,中国大陆面板厂商仍将加速高世代或AMOLED/LTPS产线的投资。中国大陆平板显示行业对掩膜版产品尤其是高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长。根据Omdia分析,预计2027年全球8.6代及以下平板显示行业掩膜版销售收入为1,293亿日元,占全球平板显示行业掩膜版销售额的比例为93.5%,8.6代及以下平板显示行业掩膜版需求保持稳定增长。(下图:全球8.6代及以下平板显示行业掩膜版销售预测,单位10,000日元)



数据来源:Omdia 2023年

根据Omdia分析,中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重,从2017年的32%上升到2022年的57%。未来随着相关产业进一步向国内转移,中国大陆平板显示行业掩膜版的需求将持续上升,预计到2026年,中国大陆平板显示行业掩膜版需求全球占比将达到60%。(下图:全球各区域平板显示掩膜版市场份额预测)



数据来源:Omdia 2023年

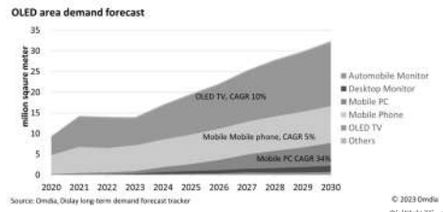
综上,报告期内及未来可预见的期间内,中国大陆的平板显示行业处于快速发展期,发展前景乐观,对掩膜版的需求将持续增加。

高精度掩膜版是生产AMOLED/LTPS及高分辨率TFT-LCD显示屏的关键要素,随着中国大陆AMOLED/LTPS、高世代面板线的陆续投产,对高精度、大尺寸的掩膜版需求将大幅增加。中国大陆掩膜版的发展滞后于平板显示投资的增长,特别在AMOLED/LTPS等高精度掩膜版上国产化率不足,仍严重依赖进口,国产替代的空间巨大。报告期及未来可预见的期间内有广阔的市场空间。

2)半导体芯片市场

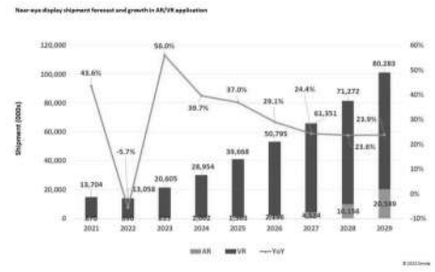
半导体芯片位于电子行业的中游,上游是电子材料和设备。半导体芯片被广泛应用于AI、通信、安防、军事、工业、金融、交通、消费电子(例如:电视、电脑、平板、手机、VR/AR等)等领域,在国家安全、经济发展和日常生活中发挥着重要的作用,是社会信息化、经济数字化的基础。世界半导体贸易统计组织(WSTS)2023年11月数据显示,2023年全球半导体市场规模约为5,201亿美元,比2022年下降9.4%。2024年营收将达5,883.64亿美元,同比增长13.1%。尽管由于市场周期性和宏观经济条件的原因,半导体芯片销售额出现了短期波动,但半导体芯片在使世界更智能、更高效、更互联方面的作用越来越大,半导体芯片市场的长期前景仍然非常强劲。

半导体芯片行业作为电子信息技术的主要代表,是整个电子信息技术行业的基础,中国大陆半导体自给率水平非常低,特别是核心芯片极度缺乏。



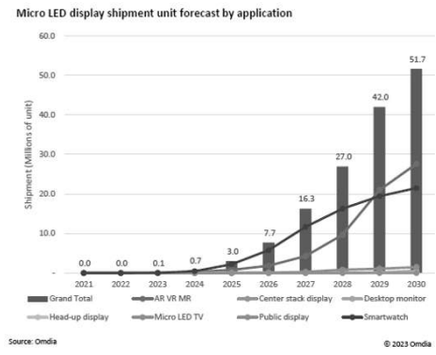
数据来源:Omdia 2023年

随着新一代信息技术的发展,消费者对显示产品的要求逐步提高,手机、平板电脑、VR、AR等移动终端向多元化显示发展,终端产品对半导体芯片和平板显示等下游厂商对掩膜版运用方面提出了更高的技术和精度要求,线缝精度要求越来越高。随着元宇宙概念延伸将推动更多厂商增加虚拟世界的投资,社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。用户端所使用的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。目前VR显示面板如头戴式显示器主流是TFT LCD、OLEDoS(Micro OLED)面板正在崛起,AR显示面板如智能眼镜主流是OLEDoS(Micro OLED)、LEDoS(MicroLED)面板也正在崛起。Omdia 2023年最新研究表明,包括 AR(增强现实)、VR(虚拟现实)和 MR(混合现实)在内的 XR(扩展现实)应用近眼显示面板出货量将在 2023 年同比增长 56%,达到 2,140 万片。



数据来源:Omdia 2023年

近年来微型发光二极管MicroLED,因其发光效率高和显示效果好而被认为是具有潜力的下一代显示技术,但由于技术难点较多,成本高,距量量产仍需时间。MicroLED产业的发展进入了全面高速的发展期,LED产业链企业、面板企业、终端品牌、高校研究院都在积极参与到MicroLED的技术研发,产能扩充等各类MicroLED的技术研发。在MicroLED技术开发期,Mini-LED作为折中技术率先推出,有望在背光端和直显端重塑产业格局。根据Omdia2023年报告,三星电视MicroLED电视供应链中部分MicroLED 产品背板采用LTPS TFT技术需要17到24片平板显示掩膜版。Omdia2023年报告,未来MicroLED电视、智能手表和智能眼镜等终端应用的需求将带动MicroLED显示版面的发展。



数据来源:Omdia 2023年

随着下游行业的产品和技术更新升级,掩膜版行业也涌现出诸多新技术,用以支持更高端产品的生产,例如AMOLED/LTPS等掩膜版生产技术、FMM掩膜版生产技术、MicroLED/ MiniLED芯片技术、Micro OLED 、3D厚胶生产技术、4K/8K高分辨率显示屏掩膜版生产技术以及平板显示用半透膜(HTM)、PSM等先进的掩膜版工艺技术。

2)半导体芯片市场

未来十年,中国半导体芯片行业有望迎来产业升级与自主可控的黄金时期,中国半导体芯片的产业结构将逐步优化升级。在海外技术封锁和贸易摩擦等不确定性因素增加的背景下,我国半导体芯片产业加速进口替代,实现半导体芯片产业自主可控已上升到国家战略高度,中国半导体芯片行业发展迎来了历史性的机遇。

第三代半导体芯片带来了新机遇,第三代半导体材料是SiC和GaN为主。SiC可以制造高耐压、大功率电力电子器件如MOSFET、IGBT等,用于高铁、智能电网、新能源汽车等行业。未来,随着第三代半导体芯片应用市场的增长,半导体芯片的成本因生产技术的不断提升而下降,其应用市场也将迎来爆发式增长,给半导体芯片掩膜版行业带来新的发展机遇。

根据全球知名市场研究与战略咨询公司Yole数据,2017-2022年全球半导体封测市场规模从533亿美元增长到815亿美元,预计2023年将达到822亿美元,2026年将达到961亿美元。半导体芯片在封装技术领域持续发展,来自AI芯片、边缘计算和网络芯片,它们需要先进封装技术以提供小尺寸和节约成本。各种先进封装技术和形式不断涌现,如SiP系统级封装、硅穿孔、2.5D、3D、先进封装(Chiplet)等。越来越多的半导体芯片企业正通过开发先进封装技术,巩固其在半导体芯片行业内的技术领先地位。如3D封装正加速在HBM、CPU、GPU中的渗透。消费电子应用领域的应用处理器、图形芯片、5G/6G 调制解调器芯片均使用扇出封装。根据全球知名市场研究与战略咨询公司Yole数据,全球封装市场结构中,先进封装占比由2014年的38%提升到了2022年的47.2%,预计2023年将达到48.8%,2026年将首次超过传统封装,占比达到50.2%。市场规模方面,2019为290亿美元,2022年增长至378亿美元,预计2023年将达到408亿美元,2026年将达到482亿美元。未来,随着半导体芯片先进封装市场的增长,半导体先进封装行业将迎来新的发展机遇。

近年来,随着半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业的快速发展,产业内出现更多新兴的需求,如低温多晶硅(LTPS)、金属氧化物(IGZO)、有源矩阵有机发光二极体(AMOLED)、MicroLED显示、硅基半导体显示、第三代半导体、先进封装(Chiplet)等技术均需要更高要求的掩膜版产品与之配套。

3)掩膜版行业未来发展趋势

掩膜版行业的发展主要受下游平板显示行业、半导体芯片行业、触控行业和电路板行业的发展影响,与下游终端行业的主流消费电子(手机、平板、可穿戴设备)、笔记本电脑、车载电子、网络通信、家用电器、LED照明、物联网、医疗电子、VR/AR产品的发展趋势密切相关,未来几年掩膜版将向更高精度和全产业链方向发展。

(1)掩膜版产品精度趋向精细化

平板显示行业,随着消费者对显示产品的要求逐步提高,手机、平板电脑等移动终端向着更高清、色彩度更饱和、更轻薄化发展。对平板显示掩膜版的半导体层、光刻分辨率、最小过孔、CD均匀性、精度、缺陷大小、洁净度均提出了更高的技术要求。根据Omdia对2020年至2022年平板显示掩膜版技术路线分析,除了允许缺陷尺寸进一步降低外,其他技术指标保持稳定。

半导体芯片行业,6英寸半导体成熟制造工艺主要为800nm、500nm、350nm和250nm等节点工艺,8英寸半导体成熟制造工艺主要为500nm、350nm、250nm、180nm、130nm和110nm等节点工艺,12英寸半导体目前境内主流制造工艺为150nm、110nm、90nm、65nm、45nm、28nm和14nm等节点工艺。中芯国际已提供14nm节点工艺的半导体芯片,台积电2022年已开始量产3nm节点工艺的半导体芯片,未来半导体芯片的制造工艺将进一步精细化工艺发展,这对与之配套的半导体芯片及封装掩膜版提出了更高要求,对线缝精度的要求越来越高,掩膜版厂商采取例如光学邻近校正(OPC)和相移掩膜(PSM)等技术来应对。根据佳能方面最新消息,该公司宣布推出新型纳米压印半导体制造设备,采用了纳米压印技术,可实现最小线宽为14纳米的图案化,相当于5纳米节点需要,生产目前可用的最先进的逻辑半导体。此外,随着掩膜版技术的进一步改进,纳米压印技术有望实现最小线宽为10 nm的电路图案,对应于2nm节点。

综上,未来掩膜版产品的精度将趋向精细化。

(2)掩膜版产品尺寸趋向稳定

自2007年液晶电视开始占据主流市场后,其平均尺寸大约按照每年增加1英寸的速度平稳增长。电视尺寸趋向大型化,国内面板基板从2018年开始稳定在11代2940 mm x3370 mm尺寸之内,平板显示行业掩膜版产品尺寸稳定在1620 mm x1780 mm以内。

(3)掩膜版行业产业链向上游拓展

掩膜版的主要原材料为掩膜版基板。同时,随着掩膜版行业下游客户对其最终产品的品质要求不断提高,促使掩膜版企业不断追求产品品质上的突破,而掩膜版基板的质量,对掩膜版产品最终品质具有重大影响。因此,从降低原材料采购成本和控制终端产品质量出发,掩膜版企业陆续向上游产业链延伸,部分企业已经具备了研磨、抛光、镀铬、涂胶等掩膜版基板全产业链的生产能力,这不仅可以有效降低原材料的采购成本,而且能够有效提升掩膜版产品质量。未来掩膜版行业内具有一定实力的企业,将逐步向上游产业链拓展

3 公司主要会计数据和财务指标

(下转B1198版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳清溢光电股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:688138　　证券简称:清溢光电

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人吴克强及会计机构负责人(会计主管人员)熊成春保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	271,823,375.62		48.54
归属于上市公司股东的净利润	49,590,830.56		155.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,700,665.25		194.24
经营活动产生的现金流量净额	57,520,338.05		4.34
基本每股收益(元/股)	0.19		171.43
稀释每股收益(元/股)	0.19		171.43
加权平均净资产收益率(%)	3.56		增加2.06个百分点
研发投入合计	12,015,170.14		14.93
研发投入占营业收入的比例(%)	4.42		减少1.29个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,225,935,899.19	2,076,683,215.28	7.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,403,197,212.29	1,383,626,338.51	1.41

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,739.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,772,223.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,986.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减,所得税影响额	865,331.65	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,890,165.31	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	48.54	主要系报告期内销售规模增长所致
归属于上市公司股东的净利润	155.22	主要系报告期内营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194.24	
基本每股收益(元/股)	171.43	主要系报告期内净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	171.43	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,776	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
苏施光掩科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	86,613,600	32.46	0	0	无	0
光掩(香港)有限公司	境外法人	73,977,300	27.73	0	0	无	0
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	24,659,100	9.24	0	0	无	0
朱雪华	境外自然人	2,800,000	1.05	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,168,171	0.81	0	0	无	0
新余市玻璃科技服务中心(有限合伙)	其他	1,200,151	0.45	0	0	无	0
尤宇昕	境外自然人	1,200,000	0.45	0	0	无	0
沈希洪	境内自然人	1,197,976	0.45	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—嘉实中证半导体产业指数增强发起式证券投资基金	其他	778,438	0.29	0	0	无	0
奥捷生	境内自然人	730,000	0.27	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏施光掩科技(深圳)有限公司	86,613,600	人民币普通股	86,613,600
光掩(香港)有限公司	73,977,300	人民币普通股	73,977,300
广东省广新控股集团有限公司	24,659,100	人民币普通股	24,659,100
朱雪华	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
香港中央结算有限公司	2,168,171	人民币普通股	2,168,171
新余市玻璃科技服务中心(有限合伙)	1,200,151	人民币普通股	1,200,151
尤宇昕	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
沈希洪	1,197,976	人民币普通股	1,197,976
中国银行股份有限公司—嘉实中证半导体产业指数增强发起式证券投资基金	778,438	人民币普通股	778,438
奥捷生	730,000	人民币普通股	730,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.光掩(香港)有限公司为公司控股股东,苏施光掩科技(深圳)有限公司是光掩(香港)有限公司100%持股的企业。
2.股东尤宇昕为公司实际控股股东香港关掩,公司持5%以上股份股东苏施光掩的实际控制人唐英敏,唐英英的母亲的兄弟。
3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

公司股东奥捷生通过投资者信用证券账户持有公司股票730,000股。除此以外,上述其他股东不存在参与融资融券或转融通业务的情况。

注:公司回购专户未纳入上表列示,截至2024年3月31日,深圳清溢光电股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,723,419股,持股比例为0.65%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:深圳清溢光电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	404,135,381.67	342,883,200.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,010,071.33	12,626,601.26
应收账款	283,642,218.67	263,269,501.48
应收款项融资	26,099,802.72